 毫欧电阻 毫欧制造	HoYH0805 陶瓷合金系列规格书	系列号	HoYH
		修订日期	2019-04-13
		版本号	Ho-A0

规格书 Specification

制造商:深圳市毫欧电子有限公司

HoYH

适用：本规格书适用于深圳市毫欧电子有限公司陶瓷合金电阻 HoYH0805 系列产品选型。

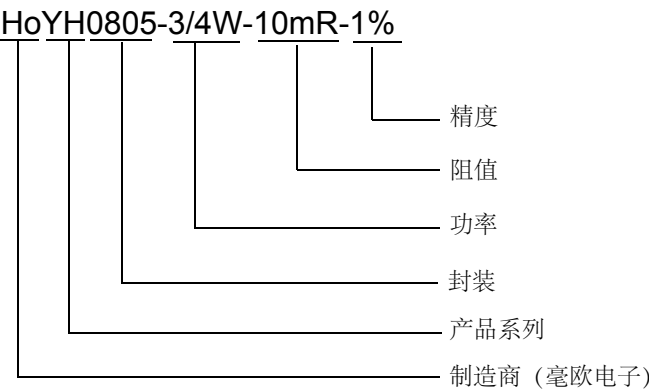
■ 产品特点 Features:

- 陶瓷合金芯片，封体工艺，焊接性能良好
- 高可靠性，高过载能力，产品精度高。
- 使用温度范围较宽无感型设计
- 电阻温度系数 $TCR \times 10^{-6}/^{\circ}C \leq 100ppm$
- 符合 ROHS 要求和无卤要求

■ 产品名称 Product Name

陶瓷合金电阻

■ 产品型号 Product number



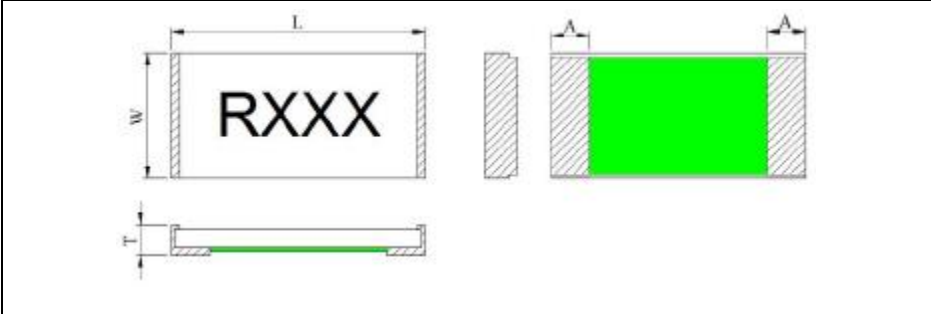
制造商	产品系列	封装	额定功率(W)	阻值(mR)	精度(%)	温度系数 TCR (ppm)
Ho 毫欧电子	YH 陶瓷合金	0805	3/4W	2mR~9mR	1%	100
				10mR~200mR	0.5%/1%	50



地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼

	HoYH0805 陶瓷合金系列规格书		系列号	HoYH
			修订日期	2019-04-13
			版本号	Ho-A0

■ 产品尺寸 Product Size



产品尺寸：单位 mm					
型号	阻值	W	L	T	A
HoYH0805	2mR~3mR	1.35±0.2	2.1±0.2	0.65±0.2	0.65±0.2
	4mR~200mR	1.35±0.2	2.1±0.2	0.65±0.2	0.5±0.2

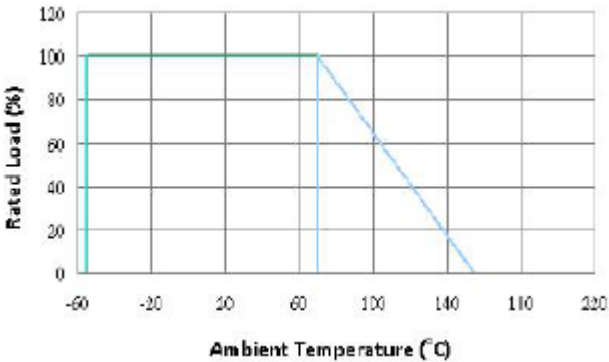
规格外阻值可依客户需求提供 / We can provide other resistance value per request

■ 电气参数 Electrical parameter

额定功率 Rated power	3/4W
阻值范围 Resistance range	2mR~200mR
最大额定电流 Max.Rated Current	1.936A~19.36A
准确度等级 AccuracyClass	0.5%、1%
电阻温度系数 T.C.R (ppm / °C)	≤50、±100
工作温度范围 Operating Temperature Range	-55℃~+155℃

■ 功率曲线 Power curve

操作温度范围 - 55 ~+155 °C 电阻温度达到 70°C时降功率示意图



在溫度+10℃~40℃、相對濕度≤75%的密閉條件下可存放 2 年。

在溫度+10℃~60℃、相對濕度為 95%的非露天下最多可存放 30 天。

地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼

■ 额定电流计算公式 The rated current is calculated by the following Formu

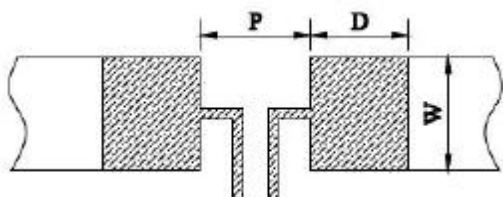
$$I = \sqrt{P/R}$$

I :Rated Current (A)

P:Rated Power (W)

R:Resistance Value (Ω)

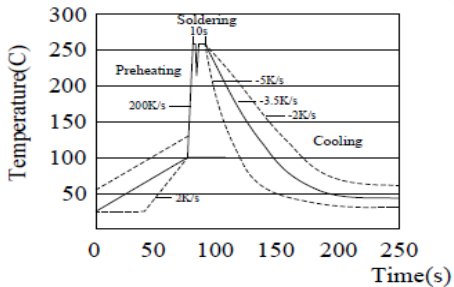
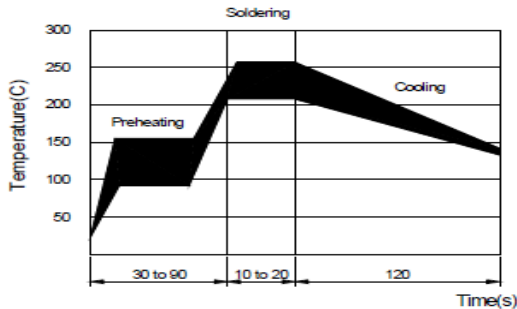
■ 建议焊盘尺寸 Recommended Solder Pad Dimension



, 立: mm

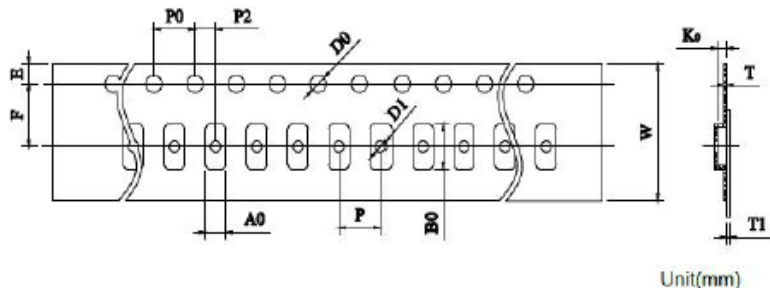
阻值	P	W	D
2mR~3mR	0.5	1.44	1.55
4mR~200 mR	0.8	1.44	1.4

■ 建议焊接参数 / Recommended Customer Soldering Parameters

预热 / Preheating : 100℃~130℃, max.100 sec. 焊锡 / Soldering: 250℃~265℃ max. 10 sec. 最高温度 / Maximum temperature : 260±5℃, max. 10sec.	预热/ Preheating : 145 ± 15℃, max.120 sec. 焊锡/ Soldering : min. 220℃, max. 60 sec. 最高温度 / Maximum temperature : 260±5℃, max. 10sec.
波峰焊曲线图 	回流焊曲线图 

地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼

■ 彩带尺寸 Ribbon size(Unit:mm)



W	8.00±0.3	P0	4.00 ±0.1	P	4.00 ±0.1	P2	2.00 ± 0.1
A0	1.68 ±0.2	B0	2.38±0.2	D0	1.5 ± 0.1	F	3.50 ± 0.1
E	1.75 ± 0.1	T	0.87 ±0.2	/	/	/	/

■ 性能测试 Performance Testing

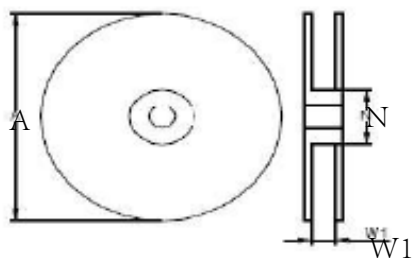
測試方法 Parameter	條件 Conditions	允收標準 Requirements
瞬間過載測試 / Short Time Over Load	P = 2.5Pr ; T=25±2°C , t = 5sec.	±(1.0%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.13
高溫測試 / High Temp. Exposure	T = +170±2°C ; t = 1000h	±(1.0%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.25
低溫測試 / Low Temp. Storage	T = -55±2°C ; t = 1000h	±(1.0%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.25
濕度負載壽命測試 / Moisture Load Life (60°C、95%RH)	Vtest = Vmax ; T=60±2°C ; RH=95% ; t= 90min ON , 30min OFF , 1000h	±(2.0%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.25
冷熱衝擊測試 / Thermal Shock	[-55°C 30min. → R.T. 3min. → +150°C 30min. → R.T. 3min], 100 個連續循環 / 100Cycles	±(1.0%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.19
在 70°C 下負載壽命測試 / Load Life at 70°C	Vtest = Vmax ; T=70±2°C ,t= 90min ON , 30min OFF,1000h	±(2%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.25
可焊性測試 / Solderability	浸入錫爐 / Dip into solder at T = 245±5°C , t = 3±0.5sec.	錫箔蓋面積/The covered area >95% IEC60115-1 4.17
抗焊熱性測試 / Resistance to Solder Heat	經熱風式迴焊爐 / Through Reflow T= 275±5°C , t =20±1sec.	±(1.0%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.18
機械衝擊測試 / Mechanical Shock	加速度 a =100G , 振幅時間 t=11ms, 5 個衝擊 a =100G , t=11ms, 5 times shock	±(1.0%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.21
基板彎曲測試 / Substrate Bending	兩支撐點間距 / Span between fulcrums : 90mm ; 振幅 / Bend Width : 2mm ; 測試板/Test board : 玻璃纖維板/ Glass-Epoxy Board ;厚度 / Thickness =1.6mm	±(1.0%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.33

■ 包裝方式 Packing

卷帶盤裝：5000pcs/盤

卷帶規格

A±5mm	N±2 (mm)	W1±1 (mm)
178	60	9



地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼